

充分なはんだ量と、良好な溶融性で、0201型チップ部品が実装可能に

Sufficient solder quantity and excellent fusibility for 0201-type chip component mounting

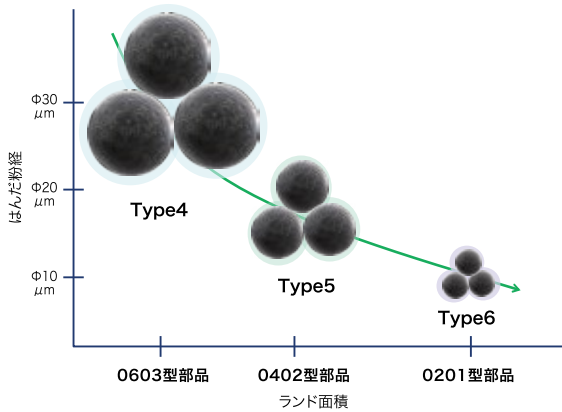
特長

- Type6サイズの微粉末の採用で、充分なはんだ量を確保
- 活性力が高いフラックスの開発で、酸化膜の除去が容易に
- 独自のフラックス開発は、リフローでの再酸化を抑制

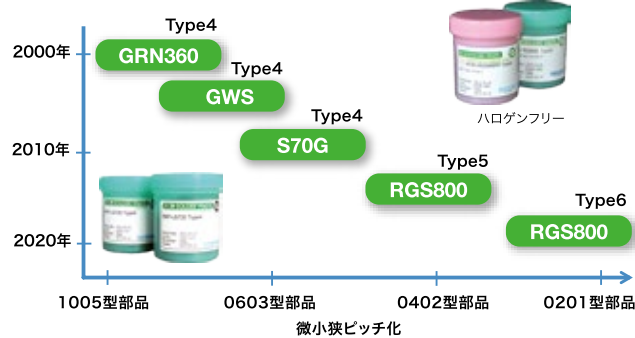


仕様

- ランド面積の微細化に伴い、はんだ粉末を微小化
0201型チップ部品用ソルダペースト



- 粉末の微細化に伴い、フラックスも開発
0201型チップ部品用ソルダペースト



- 0201型チップ部品のランドパターンには、Type6粉末が必要

はんだの粒径が大きいと、充分なはんだ量が得られない

Type4 印刷量不足の発生

Type6 十分な印刷量

平均粒径 約φ30μm 平均粒径 約φ20μm 平均粒径 約φ10μm

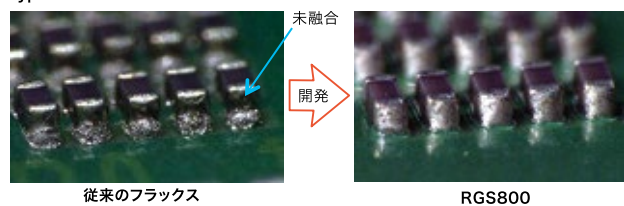
- 各種粉末で、開口130umΦ マスク厚60umのパターンに印刷

Type6で、充分な印刷量を確保

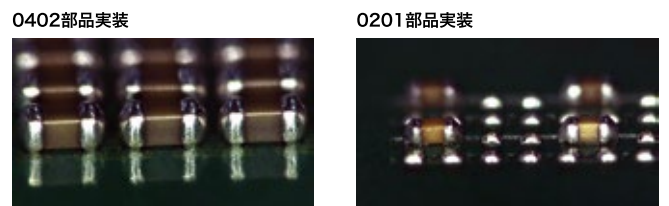


- Type6と従来フラックスのペーストでは、未融合が発生

Type6は5より表面積が2倍となり、酸化膜も2倍となる



- 超高密度実装を実現する、微小部品の実装



部品提供: (株)村田製作所様